附件一、推薦表格式(產業貢獻獎)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **申請編號：****(由本會填寫)** |  | **申請日期****(西元年/月/日)** |  |
| **基本資料** |
| **中文姓名** |  | **英文姓名** |  |
| **最高學歷** | □博士 □碩士 □學士 |
| **學校/系所** |  |
| **現職公司** |  | **職稱** |  |
| **通訊地址** |  |
| **聯絡電話** |  |
| **電子郵件** |  |
| **榮譽事蹟** |
| **榮譽/成就名稱** | **簡述內容** | **頒發機構** | **頒發日期** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **特殊貢獻事蹟** |
| (請條列式方式敘述事蹟，並提供時間說明以利參考) |
| **本申請案聯絡人** |  | **職稱** |  |
| **電話** |  | **電子郵件** |  |

附件二、參賽簡報格式(產業貢獻獎)

1.請以word直式格式製作，頁數不限。

2.請依下列結構製作簡報：

(1) 公司/團隊/個人介紹

(2) 符合評分標準之關鍵重點，請以清晰文字搭配圖片說明

* 產業貢獻獎

-個人特質(20%)：學經歷、人格特質

-特殊貢獻(80%)：長期推動產業創新並建立新興產業或模式；具特殊成就，對產業成長有卓越貢獻

附件三、推薦表

茲推薦\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_參加貴會舉辦之「TOSIA AWARD」產業貢獻獎甄選活動。

推薦理由及優良事蹟：

此致

TOSIA AWARD評選作業小組

 推 薦 人：

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 推薦機關：

 職稱：

 通訊地址：

中華民國　年　月　日

附件四、個人資料提供同意書

台灣光電暨化合物半導體產業協會

蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書

台灣光電暨化合物半導體產業協會（下稱TOSIA）為遵守個人資料保護法令及TOSIA個人資料保護政策、規章，於向您蒐集個人資料前，依法向您告知下列事項，敬請詳閱。

一、蒐集目的及類別

TOSIA因辦理或執行TOSIA AWARD業務、活動、計畫、提供服務及供TOSIA用於內部行政管理、陳報主管機關或其他合於組織規章所定業務、寄送TOSIA或產業相關活動訊息之蒐集目的，而需獲取您下列個人資料類別（包含姓名、生日、身份證字號、電話、住址、電子信箱、學經歷等其他足資識別該個人之資料）。

二、個人資料利用之期間、地區、對象及方式

除涉及國際業務或活動外，您的個人資料僅供TOSIA於中華民國領域、在前述蒐集目的之必要範圍內，以合理方式利用至蒐集目的消失為止。

三、當事人權利

您可依前述業務、活動所定規則或以信件聯繫秘書處(tosia@itri.org.tw)向TOSIA行使下列權利：

1. 查詢或請求閱覽。
2. 請求製給複製本。
3. 請求補充或更正。
4. 請求停止蒐集、處理及利用
5. 請求刪除您的個人資料。

四、不提供個人資料之權益影響

若您未提供正確或不提供個人資料，TOSIA將無法為您提供蒐集目的之相關服務。

五、您瞭解此一同意書符合個人資料保護法及相關法規之要求，且同意TOSIA留存此同意書，供日後取出查驗。

**個人資料之同意提供：**

一、本人已充分獲知且已瞭解上述TOSIA告知事項。

二、本人同意TOSIA於所列蒐集目的之必要範圍內，蒐集、處理及利用本人之個人資料。

立同意書人：

中華民國 　年　月　日

附件五、法律聲明書

聲明書

茲因本人/本公司（即立書人，以下簡稱本人）報名參加台灣光電暨化合物產業協會(下稱TOSIA)舉辦之「TOSIA AWARD」（下稱本活動），特此聲明並同意下列事項：

一、本人已完整審閱本活動之申請辦法，並同意前述活動辦法所載之注意事項。

二、本人保證過去三年內並無任何違法、欠稅情事，如有，本人願負所有法律責任，並接受主辦單位的退件處理。

三、本人所提交之參賽產品，絕無抄襲、仿冒、剽竊等侵害他人智慧財產權或其他權利之情事，如有違反，本人願負所有法律責任；如TOSIA因此取消本人參賽或得獎資格，本人願無條件歸還所得獎項，如因而致TOSIA受有損害者，並應負賠償責任。

四、本人同意無償授權TOSIA於本活動及後續宣傳之範圍內，拍攝、編輯、使用、公開展示本人之肖像，且得公開發表於平面、網路或電子媒體等傳播媒介。

五、本人願以善良管理人之注意義務，就參加本活動所知悉之一切資訊善盡保密義務，不得直接或間接以任何形式洩漏予第三人，亦不得使用於本活動目的以外之用途，如有違反致貴公司受有損害、遭主管機關裁罰或為第三人求償者，應負賠償責任。

此致

台灣光電暨化合物半導體產業協會

立同意書公司名稱:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

立同意書人身分證字號/統一編號: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

立同意書人姓名簽章:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

中華民國 　年　月　日